

SPM, MUSBS 系列

IP68 密封型 MINI USB 端口

配接:
USBC

技术规格

如需了解完整规格以及所建议的 PCB 设计, 请浏览
www.samtec.com?SPM

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点材料:
磷青铜
屏蔽材料:
磷青铜
电镀:
50μ" (1,27μm) 的镍底上镀 30μ" (0,76μm) 的金, 焊尾镀锡
工作温度范围:
-55°C 至 +125°C
额定电流:
1.9 A/触点
额定电压: 190 VAC
触点电阻:
初始最大电荷 15 mΩ
最小循环数:
1000
密封材料: 硅
符合 RoHS 规范要求: 是
可无铅焊接: 是

还提供

- 密封型 USB 和 RJ45 端口正在开发。请致电 Samtec。
- 请参见我们的 AccliMate™ IP68 密封型连接器, 适用于所有规格的加固面板与 I/O 接口。

MUSBS-05-S-B-TH-TR



SPM-05-S-B-VT1-PF



SPM-05-S-B-RA-PF



SPM

位置数

电镀

B

端接

PF

-05

-S

= 配接区域镀 30μ" (0,76μm) 的金, 焊尾镀锡

-RA

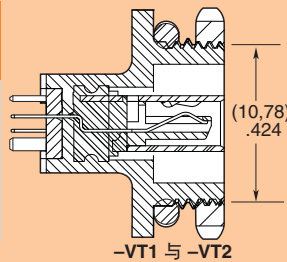
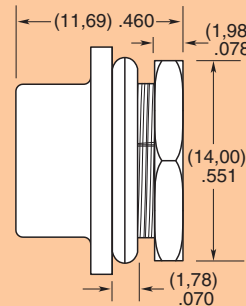
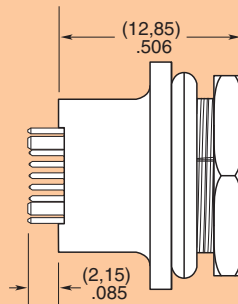
= 弯角 (最大面板厚度为 (2,03mm) .080")

-VT1

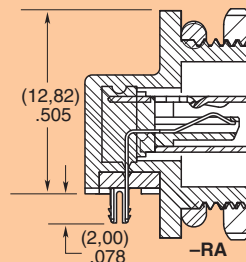
= 垂直穿孔 (最大面板厚度为 (2,03mm) .080")

-VT2

= 垂直穿孔 (最大面板厚度为 (5,21mm) .205")



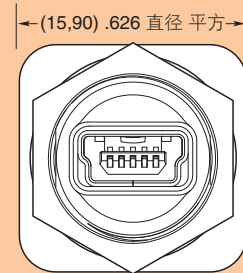
-VT1 与 -VT2



-RA

还提供

防尘帽: DCA-SPM-01



技术规格

如需了解完整规格以及所建议的 PCB 设计, 请浏览
www.samtec.com?MUSBS

绝缘体材料:
黑色高温热塑塑料
触点材料:
磷青铜
外壳材料:
磷青铜
电镀:
配接区域镀金, 外壳镀镍, 焊尾镀锡
工作温度范围:
-50°C 至 +85°C
额定电流:
2 A/触点
额定电压: 30 VRMS
触点电阻:
最大 50 mΩ
最小循环数: 5000
符合 RoHS 规范要求: 是
可无铅焊接: 是

MUSBS

触点数

电镀

类型

TH

TR

MUSBS

= 密封型 MINI USB

-05

-S

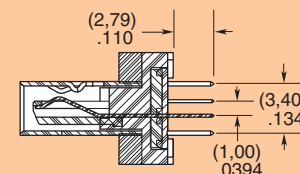
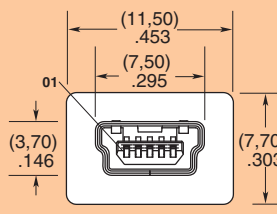
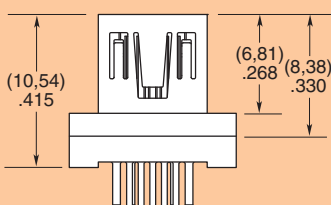
= 配接区域镀 30μ" (0,76μm) 的金, 尾端镀锡

-B

= B 型

-TR

= 卷带封装



因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM